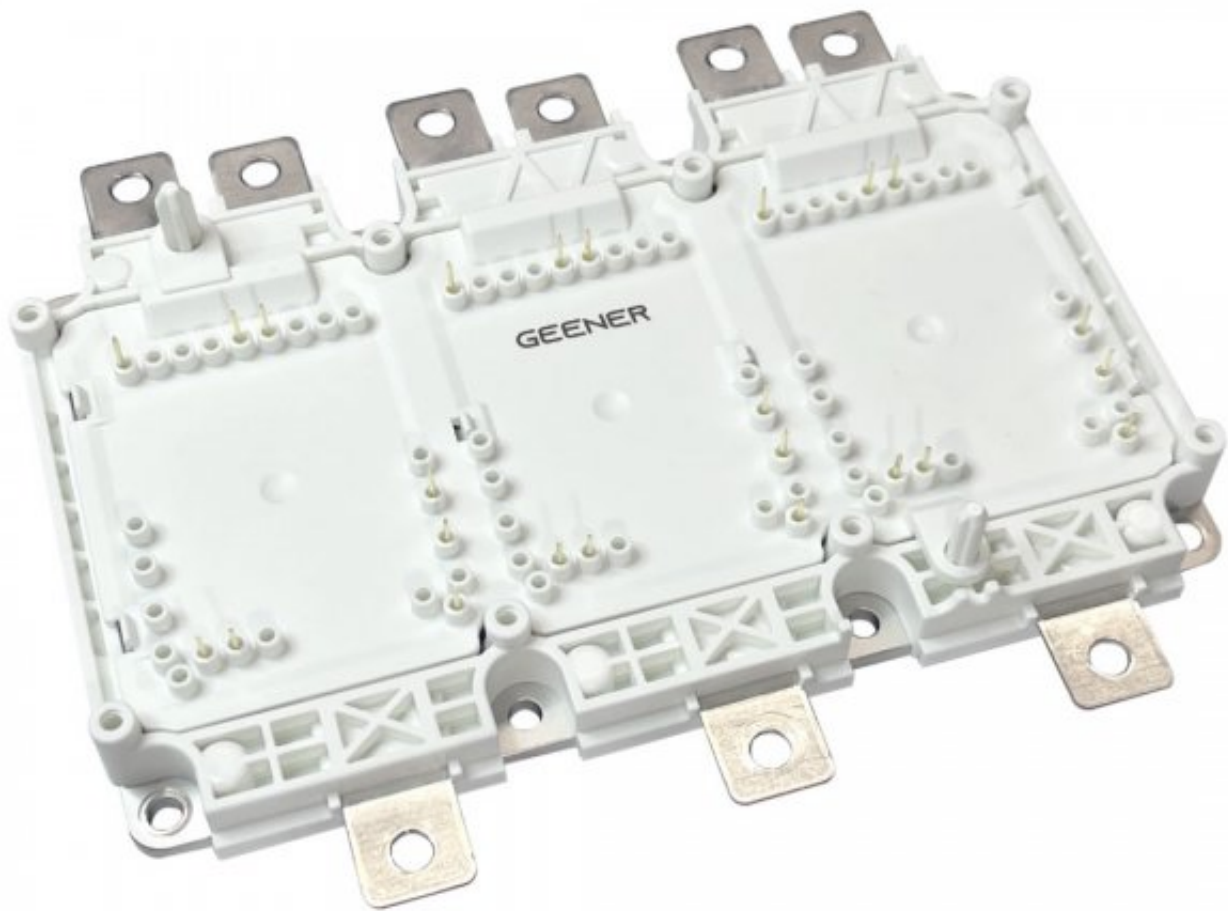


## 晶能完成首轮融资 华登领投

12月15日，吉利科技集团旗下浙江晶能微电子有限公司（以下简称晶能）宣布完成Pre-A轮融资。本轮融资由华登国际领投，嘉御资本、高榕资本、沃丰实业等机构跟投。该轮融资主要用于功率半导体模块的研发投入、产线建设以及技术团队搭建等方面。

晶能紧抓汽车电动化高增长趋势，以逆变器功率模块为切入点，通过“芯片设计+模块制造+车规认证”的组合能力，开发车规级IGBT芯片及模块、SiC器件、中低压MOSFET等产品，服务于新能源汽车、电动摩托车、光伏、储能等“双碳”产业场景。

晶能CEO潘运滨表示：“通过构建‘芯车联动’机制，紧贴需求、精研技术，晶能在芯片设计、模块制造和车规认证上锻造核心能力，为新能源汽车、电动摩托车、光伏、储能等客户提供极致性价比的产品和服务。明年将有多款产品开始装车。”



IGBT和SiC等功率模块是新能源汽车、光伏等逆变器的核心部件，被称为电力系统的“心脏”，能够实现高效的电能转化与电路控制。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/189645.html>